

シースについて

シースの説明

従来の電子部品における防塵・防水対策は筐体パッキン・ポッティング等の手段でしたが、弊社は、樹脂で封止する新技法「ホットメルト成形」によって安定した防塵・防水機能を実現しました。当技法外観製品（筐体レス・デザイン性・刻印・印刷）としてもお客様から高評価をいただいております。

想定する活用例、市場

防塵や防水機能が必要な基板・センサーなどを扱うお客様に弊社の豊富な経験とノウハウをご提供いたします。



特許など

取得予定

ニーズについて

マッチングを求める相手

【販路開拓】

電子部品、IC/抵抗部品、LED、中継コネクタ、センサー類（リール・監視・振動・車載・他）を扱う建機・車両・防災・機械/器具の製造メーカーなど。

（例：医療、計測、工作、農業、空調、カメラ、音響、福祉業界など）

成形形状	特長	代表用途	イメージ図
全体封止 (オーバーモールド ディング)	・ケースレス ・小型化 ・接着+凝集	・ECU (Electronic Control Unit) ・センサー ・コイル	
片面封止	・複数基材接着 ・包み込み形状	・センサー ・LED モジュール	
部分封止	・必要最低限の 樹脂量 ・平面接着 ・応力緩和	・制御基板	
ケース内 注入封止	・複数基材接着 ・低弾性 ・応力緩和	・センサー	
ハーネスや 配線接続部の 封止	・複数基材接着 ・接着+凝集 ・柔軟性	・グロメット 代替 ・取締チューブ 代替	
繊細部品の 封止・固定	・低圧成形性 ・低弾性	・フレキシブル 基板の封止 ・マグネットの 固定	

所属部署・役職

営業部 営業課

担当者名

石川 恵子

TEL

090-8728-6468

FAX

0224-83-6295

E-mail

k-ishikawa@nakatanisangyou.co.jp

URL

<http://www.nakatanisangyou.co.jp/>

連絡先